

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

公告编号：2023-004

**合肥新汇成微电子股份有限公司**  
**关于向全资子公司增资并投资建设 12 吋晶圆金凸块封测项目**  
**的进展公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 20 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资并投资建设 12 吋晶圆金凸块封测项目的议案》，同意公司以自有资金人民币 30,000.00 万元对全资子公司江苏汇成光电有限公司（以下简称“江苏汇成”）进行增资，并以江苏汇成作为项目实施主体，投资建设“12 吋晶圆金凸块封测项目”，该项目预计投资总额为人民币 32,294.90 万元。本次增资完成后，江苏汇成注册资本由人民币 26,164.02 万元增至人民币 56,164.02 万元，公司仍持有江苏汇成 100% 股权。具体内容见公司 2022 年 12 月 21 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《合肥新汇成微电子股份有限公司关于向全资子公司增资并投资建设 12 吋晶圆金凸块封测项目的公告》（公告编号：2022-012）。

近日，公司已完成对江苏汇成的增资，相关工商变更登记工作已完成，并取得了扬州市邗江区行政审批局换发的《营业执照》，具体信息如下：

公司名称：江苏汇成光电有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郑瑞俊

注册资本：56,164.02 万元整

成立日期：2011 年 08 月 29 日

统一社会信用代码：91321000581042566E

住所：扬州高新区金荣路 19 号

经营范围：半导体（硅片及化合物半导体）集成电路产品及半导体专用材料的开发、生产、封装和测试，销售本公司自产产品及售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2023 年 3 月 11 日